

# Verbindungstechnik Tag

## Donnerstag, 12. März 2026

In der Umweltarena Spreitenbach



Alle Infos finden Sie  
auch Online



### Themen: Bonden, Mikroschweissen, Löten, Kleben und Inspizieren

<span style="font-size: 2em;">○</span> <span style="font-size: 1em;">08:45</span> <b>Begrüssung</b> Raphael Burkart, Hilpert electronics AG	<span style="font-size: 1em;">09:00</span> <b>Material, Bondverfahren, Prüfmittel, hohe Drahtbondqualität ist planbar!</b> Stefan Schmitz, Bond IQ
	<span style="font-size: 1em;">10:00</span> <b>GHZ Plasma Technologies – Back End Applications</b> Jochen Reeh , PVA Metrology & Plasma Solutions GmbH
	<span style="font-size: 1em;">10:20</span> <b>Die einzige Lötpaste? ... Eigenschaften, auf die Sie bei der Auswahl Ihrer Lötpaste achten sollten!</b> Markus Schmidt, MacDermid Alpha
	<span style="font-size: 1em;">10:40</span> <b>Kaffeepause</b>
	<span style="font-size: 1em;">11:00</span> <b>Dampfphase – Perfekt gelötete Verbindungen durch den richtigen Prozess</b> Michael Hanke, Rehm Thermal Systems
	<span style="font-size: 1em;">11:30</span> <b>How To – Die richtigen Materialien für optimale Verlässlichkeit Ihrer Baugruppen</b> Michelle Clement, NAMICS Europe GmbH
	<span style="font-size: 1em;">12:00</span> <b>Mittagessen im Restaurant «KLIMA» Motto: «Nachhaltig ist modern»</b>
	<span style="font-size: 1em;">13:00</span> <b>Sauberkeit, Schichtbehaftung, Parameteroptimierung: Die Grundpfeiler zuverlässiger Drahtverbindungen</b> Stefan Schmitz, Bond IQ
	<span style="font-size: 1em;">14:00</span> <b>Sichere Verbindungen durch Argon beim Punktschweissen</b> Maximilian Neuner, Fraunhofer-Institut für Giesserei-, Composite- und Verarbeitungstechnik IGCV
	<span style="font-size: 1em;">14:20</span> <b>Oberflächenreinheit als Voraussetzung prozesssicherer Verbindungen</b> Stephan Whyrich, SYSTRONIC Produktionstechnologie GmbH & Co. KG
	<span style="font-size: 1em;">14:35</span> <b>Kaffeepause</b>
	<span style="font-size: 1em;">15:00</span> <b>Wie vermeidet man Verbindungen die man nicht will?</b> Gianfranco Sinistra, REHM Thermal Systems
	<span style="font-size: 1em;">15:30</span> <b>Trends in Robotic Soldering</b> Raphael Luchs, ELMOTEC AG
	<span style="font-size: 1em;">16:00</span> <b>Diskussionsrunde und Zusammenfassung – Hinweis zum Best-practice Drahtbond Workshop</b> Raphael Burkart, Hilpert electronics AG



### ANFAHRT UND KONTAKT

Nutzen Sie die Möglichkeit, sich ausführlich zu informieren und stellen Sie unseren Experten alle Fragen, die für Sie von Belang sind.  
Die Veranstaltung findet in der Umweltarena Spreitenbach statt.  
Die Adresse lautet: Türlackerstrasse 4, 8957 Spreitenbach  
Parkplätze stehen zur Verfügung (Parkhaus)  
Die Umweltarena ist gut mit den ÖV's erreichbar.

Melden Sie sich heute noch an: office@hilpert.ch  
Telefon: +41 56 483 25 25

### UNSERE REFERENTEN UND PARTNER

